

华泰联合证券有限责任公司
关于成都华微电子科技股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：成都华微
保荐代表人姓名：张若思	联系电话：010-5683 9300
保荐代表人姓名：廖君	联系电话：010-5683 9300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“成都华微”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对成都华微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入27,961.62万元，同比下降38.55%；实现归属于上市公司股东的净利润7,328.43万元，同比下降50.22%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,648.10万元，同比下降66.88%，主要原因系公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域，受行业整体环境影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等原因，公司经营业绩出现同比下降的情形。

未来若受国际政治经济环境或国家相关产业政策等因素的影响，特种集成电路的下游市场需求出现持续波动，公司可能存在经营业绩进一步下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术迭代及新品研发能力不足的风险

公司所在的集成电路设计行业属于人才与技术密集型行业，产品与技术的升级迭代速度较快。国际领先的半导体企业均经历了较长时期的发展，拥有成熟的研发体系及团队，具有丰富的技术储备，通过众多知识产权构筑了较为稳固的技术壁垒。公司目前仍在快速发展期，在相关技术研发方面相较国际领先企业尚处于追赶阶段。

未来公司如果不能准确把握市场发展动态，未能保持持续的创新能力，或者未能紧跟下游需求的发展趋势，将可能导致公司的技术与产品研发方向出现判断失误，不能持续提供适应市场需求的产品，进而导致公司市场竞争力下降。

2、技术研发及产业化未达预期的风险

由于集成电路行业对于研发水平的要求较高，公司所布局的产品研发技术难度高、资金投入大，技术成果产业化和市场化的进程具有一定不确定性，如果在研发过程中出现关键性能及指标不达预期、核心技术未能突破等情况，公司将面临前期的研发支出难以收回、预计效益难以达到的风险。

（三）经营风险

1、客户集中度较高的风险

公司从事特种领域的集成电路产品，下游客户以包括中国电科集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团在内的央企集团下属单位为主。上述央企集团下属单位数量众多，各下属单位在生产经营等方面保持一定的独立性，报告期内公司按单体口径的前十大客户合计收入金额占营业收入的比例均较高，形成了相对稳定的合作关系，是公司销售收入的主要构成。

如果未来公司主要客户的采购需求发生重大变化，或公司因技术迭代、产品质量等原因无法继续满足客户的采购需求，导致公司重要客户的销售情况发生不

利变化，则会对公司的经营产生不利影响。

2、筛选成品率波动风险

公司产品应用于特种领域，对集成电路的性能要求较高，在产品质量、稳定性、可靠性等方面需确保接近零缺陷且能够适应不同应用环境。因此，公司部分产品受制造工艺偏差影响，可能会存在良率降低风险，若公司产品的良率发生较大波动，将会导致相应产品实际结存及销售结转的成本相对较高，毛利率水平有所下降或存在波动的风险。

（四）财务风险

1、应收账款回收的风险

上半年，国内经济形势仍未得到有效改善，加上许多客户付款资金主要来源于年末的拨款，客户回款积极性较低，公司应收账款规模仍在不断扩大。报告期末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例较高。

公司主要客户为特种领域的大型集团化客户，受行业特性影响，客户会根据自身资金安排进行付款。如未来行业总体需求发生波动或特定客户发生经营困难，公司将面临应收账款及应收票据持续增长、回款不及时甚至无法回收的情形。

2、存货周转及跌价风险

因公司产品为特种集成电路产品，需经下游客户验收才能确认收入并结转成本，而行业客户验收周期一般较长，因此整体存货周转率较低。

如未来市场需求发生变化、市场竞争进一步加剧、技术迭代导致产品升级加速，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法顺利销售，进而导致存货跌价的风险。

（五）行业风险

1、晶圆供应链稳定性及采购价格波动风险

公司为集成电路设计企业，采用行业通用的Fabless经营模式，主要负责芯片的研发、设计、测试与销售，晶圆加工、封装等环节由专业的外协厂商完成。近

年来，随着集成电路行业国际产业链格局急剧变化，原材料及晶圆制造供应链存在一定风险。

如公司当前合作的主要供应商中断、终止业务合作关系，要求提升采购价格或延迟交货期限，公司短期内无法转向其他可替代供应商进行采购，可能导致公司的晶圆采购需求无法满足或者生产成本有所增加，进而对公司的产品生产及经营业绩造成不利影响。

2、下游需求及产品销售价格波动风险

公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域。近年来，在集成电路特别是特种领域产品国产化的大背景下，下游行业需求呈现快速增长的趋势。且特种领域对集成电路产品在稳定性、可靠性等方面要求更高，同时产品存在小批次、多品种等特点，导致产品技术难度大，前期研发投入多，因此呈现出高研发投入及高毛利水平的特点。

如未来受国际政治经济环境或国家相关产业政策等因素的影响，如果特种集成电路的下游市场需求出现一定波动，或者因市场竞争加剧导致产品销售价格有所下降，公司无法根据下游需求而调整经营策略与生产研发方向，将导致公司核心竞争实力下降，产品的销量或销售价格受到影响，从而对公司销售收入及毛利率等经营业绩指标造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

本报告期，公司主要财务数据及指标情况如下：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	同期增减(%)
--------	-----------	-----------	---------

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	同期增减(%)
营业收入	279,616,209.26	455,049,898.51	-38.55
归属于上市公司股东的净利润	73,284,314.34	147,209,281.97	-50.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,480,951.92	140,335,271.29	-66.88
经营活动产生的现金流量净额	-14,146,133.16	-23,523,591.48	不适用
主要会计数据	2024年6月末	2023年6月末	增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,743,439,230.67	1,312,814,437.45	108.97
总资产	3,420,935,231.85	2,274,217,612.93	50.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.26	-69.23
加权平均净资产收益率(%)	3.19	14.03	减少 10.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.04	13.38	减少 11.34 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	26.25	23.09	增加 3.16 个百分点

(三) 主要财务指标的变动原因及合理性说明

报告期内，公司实现营业收入27,961.62万元，同比下降38.55%，主要原因系公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域，受行业整体环境影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等原因，公司订单规模同比有所缩减；实现归属于上市公司股东的净利润7,328.43万元，同比下降50.22%，主要系在营业收入同比下降的情况下，同时整体费用率有所升高，导致净利润有所下滑；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,648.10万元，同比下降66.88%，主要系公司政府补助金额增加所致。

同时，由于公司于2024年2月完成上市发行，股本数量、总资产以及净资产金额大幅增加，导致报告期每股收益相关指标同比下降。公司整体经营业绩的变动情况符合特种行业及公司的实际经营情况，与同行业公司经营业绩情况相比不存在重大异常。

五、核心竞争力的变化情况

（一）深厚的技术积累与完善的研发体系

公司自设立以来深耕特种集成电路领域，拥有深厚的技术积淀，建立了完善的研发体系，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果，在FPGA、高速高精度ADC、智能SoC等领域承接了多项国家重点研发计划和科技重大专项，整体技术储备位于特种集成电路设计行业第一梯队。

公司高度重视对产品及技术的研发投入，报告期内研发支出占营业收入的比例为26.25%。截至2024年6月30日，公司共拥有境内发明专利108项，境外发明专利5项，集成电路布图设计权203项，软件著作权29项。公司高度重视研发人才的引进和培养，截至报告期末，公司研发人员共计388人，占员工总数的比例为41.15%；共有核心技术人员6人，分别为高性能FPGA、高速高精度ADC/DAC、智能SoC领域产品设计以及产品检测领域的核心人员，凭借其专业的知识及技术积累，在研发项目承接及执行、产品研发及产业化、研发和质量管理体系建设等多方面为公司做出了较为突出的贡献。

（二）综合的产品布局与领先的产品优势

公司同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力，产品覆盖可编程逻辑器件CPLD/FPGA、数据转换ADC/DAC、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，包括数字和模拟芯片在内的十余类别、百余个具体产品型号，具备为客户提供特种集成电路产品一站式采购以及综合解决方案的能力，产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。

公司从设立初期便立足于可编程逻辑器件的产品研发与设计，在特种CPLD和FPGA领域始终位于国内前列，目前公司最先进的奇衍系列为采用28nm制程7,000万门级的FPGA产品，处于国内领先地位。在模拟芯片领域，公司自2012年起陆续推出多款产品，目前在24-31位超高精度ADC产品领域处于国内领先地位。

（三）完备的检测能力与严格的质量管理

特种集成电路的产品特性决定了产品需要进行全面且严苛的产品检测。公司

拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS、国防科技工业实验室认可委员会DiLAC认证的国家级检测中心，建有较为完备的特种集成电路检测线，配有一批国内外先进的高端仪器设备，能够实现公司各类特种集成电路产品的超宽温区、多功能、多参数的批产测试，完成集成电路环境可靠性试验以及失效分析试验，满足下游客户对于集成电路产品的高标准检测需求。

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制，并建立了完善的质量控制体系，并获得了从事集成电路行业所需的专门质量管理认证证书。公司编制了相应的质量管理体系文件，明确制定了公司的质量方针和质量目标，有效保障产品的品质。

（四）优秀的服务能力与广泛的市场认可

公司高度重视对于客户的综合服务，建立了具备丰富专业背景的技术支持团队，现场工程师可以协助客户进行产品的技术验证及应用支持，及时向产品设计部门反馈客户的需求，并解决客户在产品应用中遇到的各类问题。公司已建立了完善的市场销售渠道，设立了若干销售片区团队，可以实现客户需求的快速响应。

经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，主要客户包括中国电科集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团等，核心产品CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位。

综上所述，本报告期公司核心竞争力未发生重大不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

报告期内，公司在推进集成电路自主研制的过程中抓重点、攻难点，创新成果丰硕。报告期内研发投入7,341.12万元，较去年同期减少30.12%；研发投入占营业收入的比例为26.25%，较去年同期增加3.16个百分点。

（二）研发进展

报告期内，公司在主营业务方向上新申请发明专利21件，集成电路布图设计13件，软件著作权4件；新获批准发明专利3件，集成电路布图13件。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,560.00万股，每股发行价格为人民币15.69元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8,403.81万元后，募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户监管协议。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入46,333.68万元，募集资金实际余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为85,598.22万元。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	141,592.59
减：已置换预先投入金额	31,028.70
减：直接投入募投项目金额	3,712.39
减：补充流动资金项目金额	11,592.59
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	10,000.00
减：手续费支出	0.48

加：利息收入	339.03
加：募集资金现金管理收益	0.76
2024年6月30日募集资金余额	85,598.22
加：已置换预先投入但尚未转出的金额	19,000.36
其中：存放募集资金专户余额	44,598.58
募集资金现金管理余额	60,000.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (万元)
中国银行股份有限公司双流机场支行	128033287411	募集资金专用账户	12,204.17
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600006229	募集资金专用账户	6,264.26
中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	4402922029100309718	募集资金专用账户	7,101.69
中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	22808301040061687	募集资金专用账户	19,028.46
合计			44,598.58

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为310,287,034.77元，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户等额划至各自自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2024年6月30日，公司已使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，金额为10,000.00万元。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

受托银行	产品类型	余额(万元)	起止时间	预期年化收益率	赎回情况
中国银行股份有限公司 双流机场支行	大额存单	10,000.00	2024.05.13- 2024.11.13	1.70%	未赎回

受托银行	产品类型	余额(万元)	起止时间	预期年化收益率	赎回情况
中国银行股份有限公司 双流机场支行	大额存单	17,000.00	2024.05.21- 2024.11.21	1.70%	未赎回
中国建设银行股份有限公司 成都新华支行	大额存单	18,000.00	2024.05.27- 2024.11.27	1.70%	未赎回
中国工商银行股份有限公司 成都永丰路支行	结构性存款	15,000.00	2024.06.11- 2024.12.12	1.40%-2.49 %	未赎回

(七) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况


公司上市以来，截至2024年6月30日，成都华微控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变动，持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



张若思



廖 君

华泰联合证券有限责任公司

